檔　　號:
保存年限:

國立清華大學 函

地址：新竹市光復路2段101號
承辦人：李培菁
電話：03-5715131#42269
傳真：03-5713484
電子信箱：pclee@mx.nthu.edu.tw

受文者：基隆市立中山高級中學

發文日期：中華民國115年1月22日
發文字號：清奈材中心字第1159000659號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：2026科林研發清華大學半導體AI科學營活動海報.pdf、2026科林研發清華大學半導體AI科學營課程表.pdf（115DE00185_1_22134141044.pdf、115DE00185_2_22134141044.pdf）

主旨：科林研發股份有限公司訂於民國115年7月27-31日期間將與本校奈微與材料科技中心合作辦理「2026 半導體AI科學營」活動，以期激發學生對於半導體領域科學研究之興趣，請惠予協助宣傳並鼓勵學生踴躍報名參加，請查照。

說明：

一、旨揭活動訊息說明如下：

(一)活動日期：115年7月27日（一）～31日（五）。

(二)活動時間：每日09:00-19:30。

(三)活動地點：國立清華大學跨領域科學教育中心、國立清華大學創新育成大樓。

(四)住宿安排：清華會館。

(五)保險：活動期間將投保活動公共意外責任險，參與學員將為其投保旅行平安險。

(六)活動將以中文進行。

二、「2026 半導體AI科學營」活動課程全程免費，並提供餐食與住宿。

三、活動採線上報名，報名網址：https://contest.bhuntr.com/tw/lamresearchsummercamp2026/home/ 。

四、報名期限：115年3月31日（二）17:00。

五、錄取公告：115年4月30日（四）17:00，於「2026 半導體AI科學營」活動網站首頁公告。

六、活動聯絡窗口：「2026 半導體AI科學營」工作小組聯絡信箱：lamresearch_sciencecamp@bhuntr.com；聯絡電話：(02)7730-7613。

七、隨函檢附活動海報與課程表，本活動因不可抗力之特殊原因無法執行時，主辦單位有權決定更動或取消。

正本：全國高級中等學校
副本：電子公文交換章 2026/01/23 10:26:40